

## 「第1号議案」

### 一般社団法人日本実装技術振興協会 令和4年度事業報告書 (令和4年4月1日～令和5年3月31日)

#### 1、事業の目的

電子機器実装技術及びものづくりに関する学術講演会、シンポジウム及び見学会等の開催、調査研究、情報収集・提供及び移転の推進、人材育成を行い、我が国の産業の繁栄と発展に貢献することを目的とする。

#### 2、事業内容

当法人は、目的を達成するため、次の事業を行う。

- 1) 電子機器実装技術及びものづくりに関する学術講演会、シンポジウム及び見学会等の開催
- 2) 電子機器実装技術及びものづくりに関する諸問題について、調査研究
- 3) 電子機器実装技術の諸問題に関する情報収集・提供及び移転の推進
- 4) 電子機器実装技術の振興に関する人材育成
- 5) 前各号に掲げる事業に附帯する一切の業務

#### 3、具体的活動実績

事業内容(1)を実施する具体的講演会活動について下記のとおり実施した。

尚、新型コロナウイルスの影響により講演活動については、WEB会議システムの対応となった。

実施日： 令和4年5月26日

担当幹事：嶋田(日本実装技術振興協会)出居(日立システムズ)平井(太陽金網)

テーマ：「SDGsを達成する実装技術を取り巻く最新動向」

実施日： 令和4年7月21日

担当幹事：入野(昭和電工マテリアルズ)山本(中山理研)小勝(NEC)

テーマ：「光半導体、光電融合。次世代に向けた最新動向と関連技術」

実施日： 令和4年9月15日

担当幹事：本多(NPO法人 C-NET)廣瀬(アントム)梶田(NPO法人 C-NET)大熊(HTO inc)

テーマ：「新材料・センサー部品・フレキシブル 3D 実装開発の新たな方向を探る」

実施日： 令和4年11月17日

担当幹事：堀野(ピコテック)太田(日本気象学会)二木(パナソニック)

テーマ：「最近の実装トピックス」

実施日： 令和5年1月19日

担当幹事：阿部(ナミックス)青木(日本環境技術推進機構)安保(日本実装技術振興協会)

テーマ：「次世代半導体実装のトレンドを探る」

実施日： 令和5年3月16日

担当幹事：間ヶ部(セイコーエプソン)八甫谷(ダイセル)齊藤(ケミロン)

テーマ：「日本の次世代を支えるパワーエレクトロニクス、3D パッケージ技術  
(大阪大学 F4D ラボツアー)」

—以上—